

Cesto A Fiore Per Pulizia Umida In Ptfе Ad Alta Purezza, Portaplastchette Singolo Per Incisione, Personalizzabile, Portapiastre Per Maschere Da 4 Pollici

Numero articolo: PL-CP66



introduzione

I cesti a fiore per pulizia umida in PTFE ad alta purezza offrono una resistenza chimica eccezionale per la lavorazione di wafer semiconduttori. Questi portaplastchette per incisione personalizzabili garantiscono una pulizia per immersione e una manipolazione senza contaminazione per substrati delicati in ambienti di laboratorio e industriali impegnativi. Contattateci per soluzioni fluoropolimeriche su misura.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Pulizia di wafer semiconduttori	Immersione di wafer di silicio nelle sequenze di pulizia RCA (SC-1 e SC-2) per rimuovere contaminanti organici e metallici.	Previene la contaminazione incrociata e garantisce una lavorazione ad alta purezza.
Incisione chimica umida	Incisione di precisione di film sottili (SiO ₂ , Si ₃ N ₄) utilizzando bagni di acido fluoridrico o fosforico a temperature elevate.	Mantiene l'integrità strutturale in ambienti con acidi aggressivi.
Lavorazione di piastre per maschere	Manipolazione e pulizia specializzate di fotomaschere utilizzate nella litografia per garantire un trasferimento del pattern senza difetti.	Scanalature di precisione prevengono danni alla superficie della maschera indotti dal contatto.
Fabbricazione di celle solari	Lavorazione in serie di wafer di silicio per la texturizzazione e la rimozione del vetro di silicato di fosforo (PSG).	Elevata produttività e durata nei cicli di produzione ad alto volume.
Preparazione di vetro conduttivo	Pulizia e preparazione di vetro rivestito ITO/FTO per la produzione di optoelettronica e display.	Punti di contatto minimi prevengono i graffi sui strati conduttivi delicati.
Sviluppo MEMS	Manipolazione di sistemi microelettromeccanici multistrato durante complessi processi di incisione dello strato sacrificale.	L'inerzia chimica garantisce che le microstrutture delicate non vengano danneggiate.
Ricerca e sviluppo su scala di laboratorio	Trattamento di substrati in piccoli lotti nella ricerca accademica e industriale per lo sviluppo di nuovi materiali.	La personalizzazione versatile consente di gestire forme e dimensioni di substrato non standard.

Parametro	Dettagli delle specifiche (Modello: PL-CP66)
Composizione del materiale	PTFE (Politetrafluoroetilene) vergine ad alta purezza al 100%
Temperatura massima di esercizio	+260°C (continuo)
Temperatura minima di esercizio	-200°C
Compatibilità chimica	Universale (pH 0-14); resistente a HF, acqua regia, soluzione Piranha
Dimensione standard del substrato	4 pollici (100 mm) - personalizzabile per tutti i diametri

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Parametro	Dettagli delle specifiche (Modello: PL-CP66)	
Configurazione delle scanalature	Varianti a singolo wafer o multi-wafer disponibili	
Profondità/larghezza delle scanalature	Completamente personalizzabile in base allo spessore del substrato e alle esigenze di stabilità	
Design della maniglia	Maniglie verticali fisse, rimovibili o a bilanciere (personalizzabili)	
Metodo di fabbricazione	Lavorazione di precisione CNC (zero contaminazione da stampaggio)	
Finitura superficiale	Finitura lavorata ad alta levigatura e bassa porosità	